**2024年度江苏省科学技术奖提名项目公示内容**

一、提名单位：盐城市科技局

二、项目名称: 高可靠性活性金属钎焊覆铜陶瓷载板

三、提名奖种：科技进步奖

四、完成人:王斌、张恩荣、傅仁利、马敬伟、窦正旭、贺贤汉、麻长胜、孙泉、葛荘

五、完成单位：江苏富乐华半导体科技股份有限公司、南京航空航天大学、江苏富乐华功率半导体研究院有限公司、江苏宏微科技股份有限公司

六、主要知识产权和标准规范目录（不超过10件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 知识产权（标准） 类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家（地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准 起草单位） | 发明人（标准起草人） | 知识产权 （标准）有效状态 |
| 1 | 发明 | 一种高可靠性氮化硅覆铜陶瓷基板的铜瓷界面结构及其制备方法 | 中国大陆 | ZL 2020 10139272.5 | 2022-02-25 | 证书号 第 4958834号 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 | 王斌；贺贤 汉 ； 郭 建岳 ； 张 恩荣 ； 马 敬 伟；孙泉 | 有效 |
| 2 | 发明 | 一种氮化硅瓷片界面改性方法及覆铜陶瓷基板制备方法 | 中国大陆 | ZL 2020 10709632.0 | 2022-02-18 | 证书号 第 4946691号 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 | 葛荘；贺贤 汉；王斌； 欧阳鹏；孙泉；张恩荣 | 有效 |
| 3 | 发明 | 一种氮化硅瓷片界面改性方法及覆铜陶瓷基板制备方法 | 中国大陆 | ZL 2020 10709632.0 | 2022-07-12 | 证书号 第 5300569号 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 | 王斌；贺贤 汉 ； 欧 阳 鹏；孙泉； 葛荘；戴洪 兴 | 有效 |
| 4 | 发明 | 一种陶瓷浆料混胶均匀性预 检测方法 | 中国大陆 | ZL 2022 10484247. X | 2023-11-10 | 证书号 第 6478220号 | 江苏富乐华功率半导体研究院有限公司 | 葛荘;贺贤 汉 ;王斌 ;余 祖森;崔梦 德 ;王榕 | 有效 |
| 5 | 发明 | 一种氮化硅生坯的干燥方法 | 中国大陆 | ZL 2023 10589263. X | 2024-04-09 | 证书号 第 6888033号 | 江苏富乐华功率半导体研究 院有限公司 | 王斌 ;葛荘 ; 丁闯;丁颖颖 ;何竟宇 | 有效 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 发明 | 一种氮化硅陶瓷晶粒的量化评估测试方法 | 中国大陆 | ZL 2022 11547387.3 | 2023-11-14 | 证书号 第 6483023号 | 江苏富乐华功率半导体研究 院有限公司 | 葛荘;贺贤 汉 ;张家涵 ; 王斌 ; 丁颖 颖 ;孙泉 ;孙日升 周建华 | 有效 |
| 7 | 发明 | 一种提高覆铜陶瓷基板剥离强度可靠性的 制备方法 | 中国大陆 | ZL 2023 11789475.9 | 2024-09-03 | 证书号 第 7341110号 | 江苏富乐华功率半导体研究 院有限公司 | 王斌 ;唐 冬 梅 ;窦正旭 ; 孙泉 | 有效 |
| 8 | 发明 | 一种铜/氮化铝陶瓷复合导热基板的制作方法 | 中国大陆 | ZL 2014 1 0284022.5 | 2014-06-24 | 证书号 第2220957号 | 南京航空航天大学 | 傅仁利；张鹏飞；涂兴龙；方军；蒋维娜 | 失效 |
| 9 | 发明 | 一种激光辅助化学镀制备精细陶瓷电路板 的方法 | 中国大陆 | ZL 2024 10133774.5 | 2024-12-13 | 证书号 第 7594123号 | 南京航空航天大学 | 傅仁利；陆 冉 ； 胡 昀嘉 ； 李 秀 梅；冉瑾瑾 | 有效 |
| 10 | 发明 | 功率半导体器 件 | 中国大陆 | ZL 2021 10526994.0 | 2023-07-04 | 证 书 号 第 6112398号 | 江苏宏微科技股份有限公司 | 陈超；张海 泉 ； 麻 长胜 ； 王 晓 宝；赵善麒 | 有效 |